

SEMICON[®] JAPAN 岡本工作機械

セミコンジャパン2016出展のご案内

12/14(水)~16(金) 東京ビッグサイト Booth No. 1721 (HALL1) 後工程・総合・材料ゾーン

ハイブリッドマテリアルの総合砥粒加工提案

「技術の岡本」をスローガンに、総合砥粒加工機メーカーとして7つの提案を致します。

① ハイブリッドマテリアルに対して

IoT時代に向けたSi+Cu等のハイブリッドマテリアルの同時加工による新技術

Si貫通電極ウエーハ全自動薄化加工装置がJST(国立研究所開発法人科学技術振興機構)の支援プログラム(A-STEPステージⅢ/NexTEP-Aタイプ)に採択。

TSVウエーハを高平坦かつ高均一に10 μ m厚さレベルまで薄層化する加工技術によりチップ積層型3次元集積回路の普及を促し、IoT社会の実現へ貢献します。

② 次世代パワーデバイス用材料

SiC・GaN等への低ダメージ、高速加工技術と装置

③ WL-CSP

樹脂研削の高能率化、低コスト化

④ バンプウエーハの薄化

BGテープの高精度研削技術



⑤ TSV

TTV自動補正を含めた新プロセス

⑥ 450mmウエーハ

次世代450mmウエーハ加工対応装置

⑦ 電子部品

LT/LN等の電子部品の研削装置

Okamoto

<http://www.okamoto.co.jp>